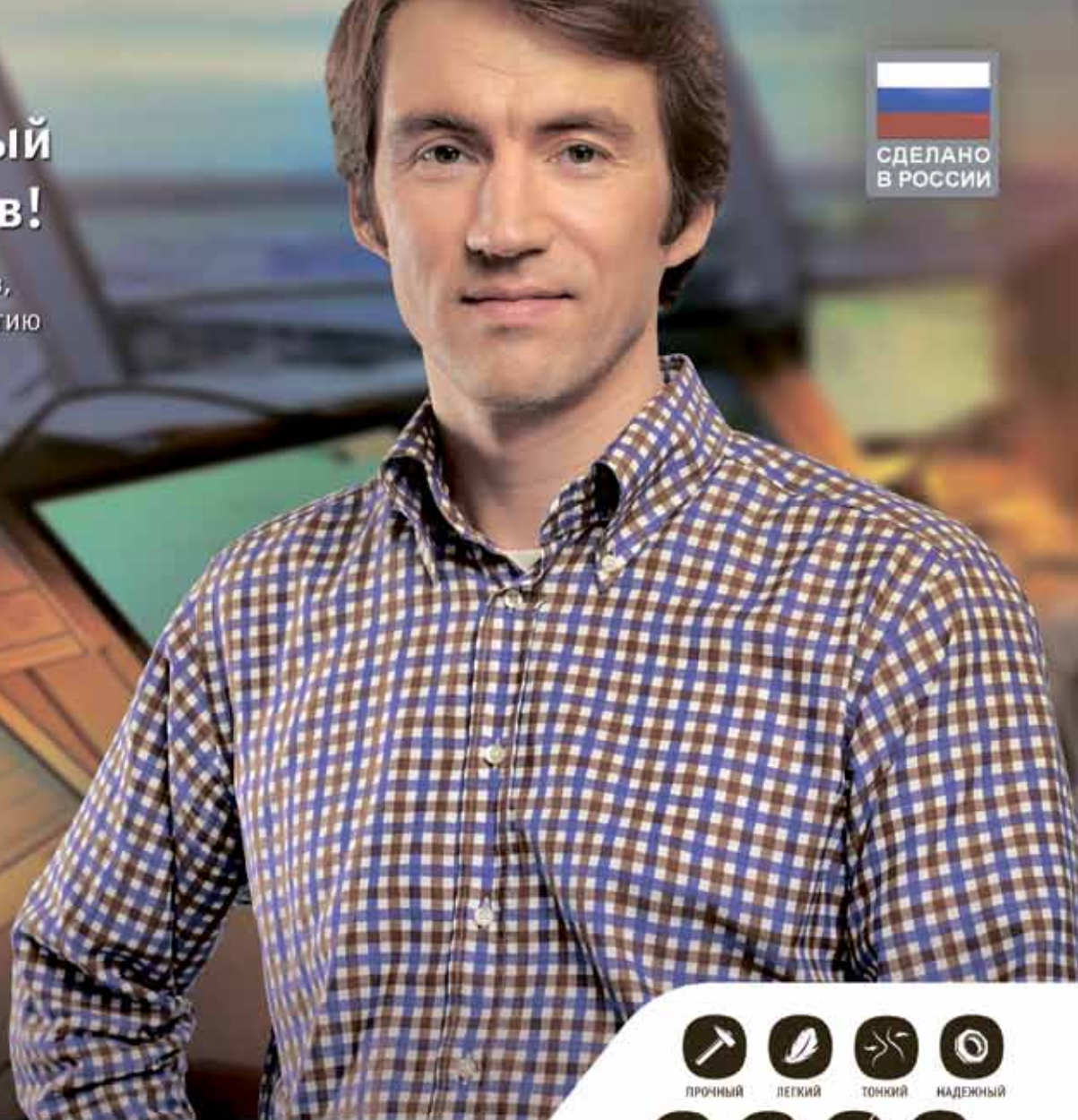
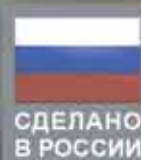


Закажите бесплатный тест-драйв!

Александр Ковалев,
директор по развитию



BLOK

Российские безвентиляторные ультратонкие компьютеры высокой надежности для ответственных систем с длительным жизненным циклом в формате 19" VoxPC класса SWaP-C Premium: энергетика, оборона, транспорт

Сделано для АСУ ТП
BLOK Industrial
ЛКЖТ.466259.012ТУ

Группа 1.1-1.4.1, 2.1.1, 2.3.1
ГОСТ РВ 20.39.304
BLOK Rugged
ЛКЖТ.466259.023ТУ

- Intel Embedded Xeon/i7/i5/i3 до 3,7 ГГц
- До 32 ГБ SDRAM
- 4 x G Ethernet & 6 x USB & HD Audio
- 3 x DisplayPort до 4K
- 2 x SATA III 2,5" SSD/HDD
- 2 x PSU 220 AC Auto
- 2 x mPCI Express & SIM
- 2 x RS232 с гальваноразвязкой
- Работа: -10+50°C (E1) / -40+70°C (E2)
- Удар: до 75 г
- Вибрация: 5 г/0,5-500 Гц
- MTBF: 50 000 часов
- Сертификация BLOK: ТС, ГОСТ Р
- Сертификация "РТСофт": ISO9001, ФСТЭК, Ростехнадзор
- Срок поставки: 0-16 недель

3А ИМПОРТО
МЕЩЕНИЕ
ПРОГРАММА

COM 
Express

<http://blok.rtsoft.ru>

RTSoft

АО «РТСофт» анонсирует доступность модулей COM Express на базе Intel® Core™ / Xeon® E 8-го поколения с 6 ядрами на борту

АО «РТСофт» и международный холдинг Kontron AG анонсируют старт продаж нового поколения «компьютеров на модуле» в стандарте PICMG COM.0 R3.0 COM Express Type 6 (COMe-bCL6) на базе 8-го поколения встраиваемых микропроцессоров компании Intel® Core™ / Xeon® E (кодированное название – Coffee Lake), выполненных в соответствии с техпроцессом 14++ нм, с коммерческой доступностью не менее 7 лет.



Аппаратура COM Express на базе 8-го поколения Intel® Core™ / Xeon® E устанавливает новые стандарты производительности, энергоэффективности, функциональности и защищенности для быстрой разработки самых разнообразных целевых приложений, где критически важно минимизировать важнейшие критерии конструирования встраиваемого оборудования SWaP-C (габариты – Size, вес – Weight, энергопотребление – Power и стоимость – Cost) наряду с обеспечением высоких показателей надежности.

В линейку Embedded микропроцессоров Intel, доступных для нового поколения COM Express, включены:

- ▶ **Xeon® E-2176M:** 12 МБ SmartCache, 6 ядер 2,7 / 4,4 ГГц, GT2 Ultra HD P630, TDP 45 / 35 Вт, CM246;
- ▶ **Core™ i7-8850H:** 9 МБ SmartCache, 6 ядер 2,6 / 4,3 ГГц, GT2 Ultra HD 630, TDP 45 / 35 Вт, QM370;
- ▶ **Core™ i5-8400H:** 8 МБ SmartCache, 4 ядра 2,5 / 4,2 ГГц, GT2 Ultra HD 630, TDP 45 / 35 Вт, QM370.

Новые модули обеспечивают поддержку до 64 ГБ DDR4 2666 ECC со скоростью до 41,8 ГБ/с, имеют опциональный бортовой NVMe SSD до 1 ТБ, поддерживают работу трех независимых графических интерфейсов (DisplayPort/HDMI/eDP) с разрешением до 4096 × 2304 @ 60 Гц и аппаратным кодированием/декодированием мультимедийного контента, включая HEVC 10 бит.

Разработчики собственного целевого оборудования на основе модулей COMe-bCL6 по достоинству оценят удобства создания подсистем вво-

да/вывода на базе гибко конфигурируемого PCI Express 3.0, функциональность четырех USB 3.1 со скоростью передачи до 10 Гбит/с, развитость BIOS/EFI AMI Aptio V, поддержку Intel Optane и великолепные возможности архитектуры 8-го поколения по администрированию, оптимизации, кибербезопасности и совместимости.

Модули COMe-bCL6 выпускаются в трех исполнениях, различающихся диапазоном рабочих температур при эксплуатации: от 0 до +60 °С, от –25 до +75 °С и от –40 до +85 °С. Это дает большие преимущества по созданию совместимого оборудования самого широкого назначения по оптимальной цене.

Использование новых модулей гарантирует разработчикам максимум свободы и удобства в выборе операционных систем класса Windows, Linux, QNX, VxWorks, LynxOS и современных инструментальных средств разработки для реализации практически всех важнейших концепций применения передовой вычислительной техники класса IoT, IIoT, MIIoT и принципов конструирования ответственной COTS-аппаратуры.

Применение модулей COMe-bCL6 обеспечивает возможность быстро и бюджетно вывести на рынок конкурентоспособные отечественные конечные решения мирового уровня для промышленных, транспортных, телекоммуникационных, медицинских и иных приложений. Планируемый срок коммерческой доступности модулей – не менее 7 лет, что делает их великолепной платформой для разработки любых критичных к надежности и длительности жизненного цикла приложений.

Модули COMe-bCL6 на базе поколения Coffee Lake Intel® Core™ / Xeon® E будут валидированы для серийных отечественных промышленных платформ BLOK Industrial и BLOK Rugged в течение 3-го квартала 2018 года.

Предсерийные образцы линеек BLOK для новых стартапов на базе Xeon E и Core i7 8-го поколения можно заказать уже сейчас.

С дополнительной информацией о модулях COMe-bCL6 можно ознакомиться на сайте www.kontron.com и в офисах компании «РТСофт», стратегического партнера холдинга Kontron в России и странах СНГ.

АО «РТСофт», г. Москва,
тел.: +7 (495) 967-1505,
e-mail: sales@rtsoft.msk.ru,
сайт: blok.rtsoft.ru